

公開番号 又は 特許番号	特開 2013-147767
発明名称	電子部品実装用織地、電子部品実装体及びそれを用いた布帛
出願人 又は 権利者	独立行政法人産業技術総合研究所、福井県
想定デバイス	シート型健康デバイス、環境物質センシングテープ、アンビエントデバイス、エネルギーハーベスティング
要約	<p>【利用分野】 電子部品を実装可能な織地、その織地に電子部品を実装した実装体及びその実装体を配列した布帛に関するもの。</p> <p>【発明の内容】 引張りや折り曲げに対して従来の布帛と同様の耐久性を備えている電子部品実装用織地、電子部品実装体及びそれを用いた布帛を提供する。そのために、電子部品実装用織地は、並列配置された複数の導電糸 2 及び絶縁糸 3 が配列された経糸と絶縁糸 4 が配列された緯糸とを織成して形成された複数の接続領域 A と、接続領域 A の間に絶縁糸 5 が配列された経糸と絶縁糸 4 が配列された緯糸とを織成して形成されるとともに電子部品を配置する空隙が形成可能となるように形成された実装領域 B とを備えている</p>
図面	<p>(a)</p> <p>(b)</p>